



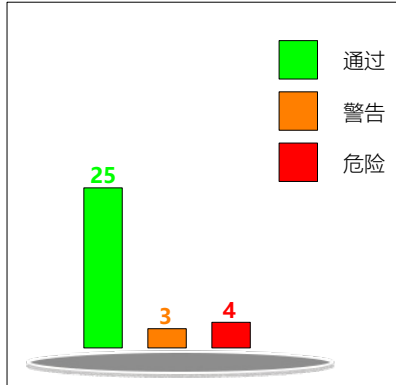
关注公众号

检查报告

时间： 2023-09-22

文件名：智能车驱动板

层数： 2 PCB板厚： 1.60 数量： 5 尺寸： 86.00*34.09 mm



PCB:¥37.40

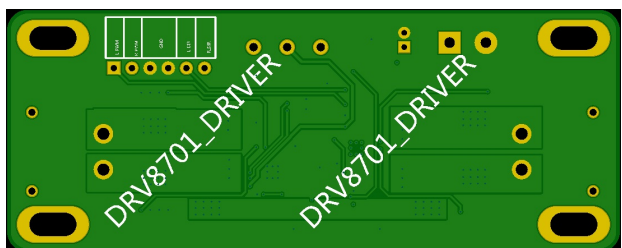
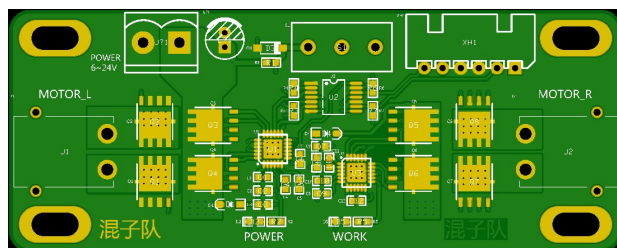
原价：87.4，优惠价：50
 完成铜厚：1oz
 线宽线距：6 mil
 最小孔径：0.25 mm
 表面工艺：有铅喷锡
 阻焊颜色：绿色
 字符颜色：白色

SMT ¥0.00

646.00
 贴片面数：1
 贴片种类：8
 贴片焊盘：192
 是否插件：0
 插件种类：5
 插件焊盘：21

基础参数	线宽/线距	8.00/6.00mil
	锣长分析	82.5837米/m²
	沉金面积	28.00%
	飞针点数	230
	利用率	88.2148%

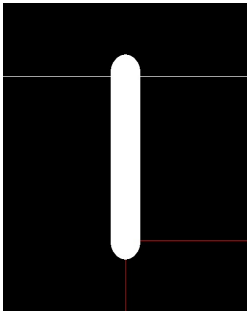
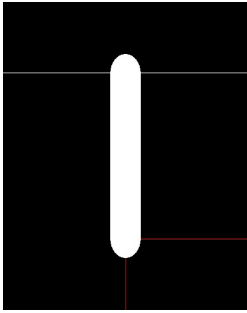
温馨提示：文件尺寸小，会影响贴片组装工序，建议尺寸大于7*7cm，优化尺寸可通过加



类型	检查项	检查子项数	结果
PCB_线路分析	开短路	1	通过
	电气信号	4	不通过 9
	最小线宽	1	通过 3
	最小间距	3	通过 918
	SMD间距	2	通过 12 ,不通过 40
	最小焊盘	3	通过 142
	网格铺铜	2	通过
	孔环大小	2	通过 206,不通过 96
	孔到线	5	通过 82
	板边距离	2	通过 82
	孔上焊盘	4	通过
PCB_钻孔分析	孔槽大小	8	通过 21
	孔到孔	4	通过 79
	孔到板边	4	通过
	孔密度	1	通过
	特殊孔	2	通过
	BoreHoleAnomaly	3	通过
PCB_阻焊分析	阻焊间距	2	通过 12 ,不通过 19
	阻焊少开窗	1	通过
	锡膏面积	1	通过
PCB_字符分析	丝印距离	1	通过 1 ,不通过 68

ASS_器件分析	元器件间距	2	通过 113,不通过 1
	器件到边缘	3	未分析
	器件丝印	0	未分析
	引脚不匹配	2	未分析
	位号长度	0	未分析
	插件器件	1	通过
ASS_引脚分析	引脚到SMD焊盘	5	未分析
	通孔引脚	6	未分析
	按压引脚	4	未分析
ASS_焊盘分析	Chip 焊盘	60	未分析
	焊盘连线	1	未分析
ASS_光学点分析	Mark点	1	不通过
	Mark点分析	3	通过

序号	检查项	规则	分析值	问题描述	问题图片	建议	数量	等级
1	电气信号_孤立铜	---	异常	您的设计存在“孤立铜”，可能会影响电气性能，		建议排查问题。	9	危险
2	SMD间距_焊盘间距	6,8,10	7.87 mil	您的“SMD焊盘”最小间距为7.87mil会影响生产效率、品质良率，而且存在连锡隐患，		建议“SMD焊盘”最小间距 ≥ 8 mil	40	警告
3	孔环大小_Via孔环	6,7,8	5.00 mil	您的“过孔孔环”最小为5.00mil会影响产品可靠性，		建议“过孔孔环”最小环 ≥ 5 mil	88	警告
4	阻焊间距_阻焊桥	5,5.5,6	0.10 mm	您的文件“阻焊间距”小于3.81mil，可能无法保留阻焊桥，影响焊接的可靠性，		建议间距 ≥ 0.15 mm	19	危险
5	丝印距离_字符到阻焊	4,5,6	0.00 mil	“字符到阻焊”极限为 ≥ 8 mil、小于8mil则生产的难度更大、存在字符上焊盘的风险、影响品质良率；您的“字符到阻焊”为0mil，		建议“字符到阻焊”改为 ≥ 12 mil	64	危险
6	元器件间距_器件间距	20,30,40	异常	器件间距不足相互干涉，可能存在器件焊接困难或无法返修。		建议器件布局移至安全距离	1	警告

7	器件到边缘 器件到导轨边	35,150,16	未分析	器件到导轨距离不足，SMT加工时可能存设备导轨撞飞器件无法焊接的风险，		建议器件离板边预留足够位置	1	危险
8	器件到边缘 矮器件到板边	35,150,16	未分析	器件到板边距离不足，铣削或分板剪切刀具需要预留足够的空间及机械加工时有撞坏器件风险，		建议器件离板边预留足够位置.	4	危险